

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 2 部門第 4 区分
 【発行日】 平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】 特表 2004-527396 (P2004-527396A)
 【公表日】 平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)
 【年通号数】 公開・登録公報 2004-035
 【出願番号】 特願 2002-571582 (P2002-571582)
 【国際特許分類第 7 版】

B 3 2 B 27/20
 B 3 2 B 27/00
 C 0 9 D 7/12
 C 0 9 D 11/00
 C 0 9 D 201/00
 C 0 9 J 7/02
 C 0 9 J 161/28
 C 0 9 J 201/00
 C 0 9 K 3/00

【F I】

B 3 2 B	27/20	Z
B 3 2 B	27/00	L
C 0 9 D	7/12	
C 0 9 D	11/00	
C 0 9 D	201/00	
C 0 9 J	7/02	Z
C 0 9 J	161/28	
C 0 9 J	201/00	
C 0 9 K	3/00	R

【手続補正書】

【提出日】 平成 17 年 3 月 14 日 (2005.3.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

堆積された材料層を含む剥離フィルムであって、該剥離フィルムは、少なくとも一方の表面を、剥離層で被覆した基板を含み、該剥離層は層状ケイ酸塩を含み、かつその上に堆積された該材料層を含み、該材料層が剥離して該材料を与えることを特徴とする、上記剥離フィルム。

【請求項 2】

層状ケイ酸塩が、スメクタイトを含む請求項 1 記載の剥離フィルム。

【請求項 3】

層状ケイ酸塩が、ヒル石、ヘクトライトまたはモンモリロナイトである請求項 1 または 2 記載の剥離フィルム。

【請求項 4】

該堆積された材料が、金属、金属化合物、ガラス、誘電体または半導体である、請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 5】

該堆積された材料が、アルミニウム、クロム、マグネシウム、銅、バナジウム、ニッケル、亜鉛、錫、銀、金、チタン、珪素、ビスマス、またはこれらの酸化物、窒化物、フッ素化合物および炭化物から選択される金属または金属化合物である請求項 4 記載の剥離フィルム。

【請求項 6】

該金属または金属化合物の層の厚みが、 $0.005 \sim 50 \mu\text{m}$ なる範囲内にある、請求項 5 記載の剥離フィルム。

【請求項 7】

該金属化合物が、 VO_2 である、請求項 5 または 6 記載の剥離フィルム。

【請求項 8】

該堆積された材料層が一連の層を含む請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 9】

該剥離層の厚みが、 $0.02 \sim 2 \mu\text{m}$ である、請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 10】

該剥離層が層状のケイ酸塩プラスバインダを含む請求項 1 ～ 9 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 11】

該バインダがメラミンホルムアルデヒドおよび/またはその誘導体を含む、請求項 10 記載の剥離フィルム。

【請求項 12】

該基板がポリイミド基板または金属基板である、請求項 1 ～ 11 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 13】

該堆積された材料層上に、接着剤層が堆積されており、かつ除去可能なライナーが、該接着剤層と接触している、請求項 1 ～ 12 のいずれか 1 項記載の剥離フィルム。

【請求項 14】

請求項 1 ～ 13 のいずれか 1 項記載の剥離フィルムの製法であって、
基板の少なくとも一方の表面を、層状ケイ酸塩の水性溶液で被覆する工程、
該層状ケイ酸塩を乾燥してフィルムとするのに十分な温度にて、該被覆した基板を加熱する工程、及び
該被覆フィルム上に、材料層を堆積する工程を含み、該材料層が剥離して該材料を与えるものである、上記方法。

【請求項 15】

該材料層を蒸気または真空蒸着法により堆積させる請求項 14 記載の剥離フィルムの製造方法。

【請求項 16】

該材料層の堆積前および/またはその間および/またはその後、加熱を行う、請求項 14 または 15 記載の剥離フィルムの製造方法。

【請求項 17】

該加熱を、 150°C またはそれ以上の温度で行う、請求項 16 記載の剥離フィルムの製造方法。

【請求項 18】

該材料層を該被覆されたフィルムから剥離する追加の工程を含む、請求項 14 ～ 17 のいずれか 1 項記載の剥離フィルムの製造方法。

【請求項 19】

該材料層を、水性条件下で剥離する、請求項 18 記載の剥離フィルムの製造方法。

【請求項 20】

請求項 14～19 のいずれか 1 項記載の方法によって得ることのできる材料。

【請求項 21】

該材料が自立型フィルムまたはフレークの形態にある、請求項 20 記載の材料。

【請求項 22】

該堆積された材料層を該剥離層から剥離して該材料を得る、請求項 1～13 のいずれか 1 項記載の剥離フィルムの使用。